
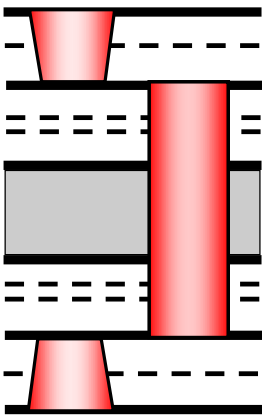


LAGENAUFBAU HDI (Standard)													
HDI06_1+4b+1_1,25_35			6 - Lagen Kern: 0,71 mm Cu 35/35 µm										
WE-Artikel Nr.:		1 + 4B + 1											
KUNDE:													
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG				
KUNDE	WE							[µm]	[µm]				
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12					
									1 x 1080	60			
2	VSK1				Folie	12 µm		35					
									2 x 1080	132			
3	2					35 µm		33					
					0,710 mm			710					
4	3		35 µm		33								
						2 x 1080	132						
5	RSK1		12 µm		35								
						1 x 1080	60						
6	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12								
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm								
					Gesamtdicke Material:			1254					
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)								
MATERIALDICKE:		1,25	+/-	0,10	mm	Datum:		Bearbeiter:					
DICKE über galv. Endoberfläche		1,34	+/-	0,13	mm								
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,40	+/-	0,15	mm								
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:							
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am		von		Revision	
05.01.2006		S. Keller		04.05.2006		M.Kress		05.01.2006		R. Schönholz		00	
										Seite:		15+	